

Title (en)

Plating bath for depositing coatings of gold and gold alloys.

Title (de)

Galvanisches Bad zur Abscheidung von Gold- und Goldlegierungsüberzügen.

Title (fr)

Bain galvanique pour le dépôt de revêtements d'or et d'alliages d'or.

Publication

**EP 0037535 A2 19811014 (DE)**

Application

**EP 81102316 A 19810327**

Priority

DE 3012999 A 19800403

Abstract (en)

[origin: US4391679A] In the electro industry, there are needed acid gold alloy baths which give glossy, ductile coatings, operate at high current densities, and contain little non-metallic impurities. This is attained by a bath based on potassium cyanoaurate (III) and an acid whereby the bath contains at least one of the alloying metals cobalt, nickel, indium, tin, zinc, or cadmium in the form of a water soluble salt, together with an amine, an aminocarboxylic acid, or a phosphonic acid and has a pH of below 3.

Abstract (de)

In der Elektrotechnik werden saure Goldlegierungsbäder benötigt, die glänzende, duktile Überzüge ergeben, bei hohen Stromdichten arbeiten und wenig nichtmetallische Verunreinigungen enthalten. Das erreicht man mit einem Bad auf der Basis von Kaliumcyanoaurat (III) und einer Säure, wobei das Bad mindestens eines der Legierungsmetalle Kobalt, Nickel, Indium, Zinn, Zink oder Cadmium in Form wasserlöslicher Salze zusammen mit einem Amin, einer Aminocarbonsäure oder Phosphonsäure enthält und einen pH-Wert von weniger als 3 aufweist.

IPC 1-7

**C25D 3/48**; **C25D 3/62**

IPC 8 full level

**C25D 3/48** (2006.01); **C25D 3/62** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25D 3/62** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE102011114931A1; EP0149830A3; EP2014801A3; DE4040526A1; DE4040526C3; DE102011114931B4; EP0198998A1; FR2538816A1; WO2013050258A2; US8357285B2; US9297087B2; US9303326B2

Designated contracting state (EPC)

AT CH FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0037535 A2 19811014**; **EP 0037535 A3 19811104**; **EP 0037535 B1 19840307**; AT E6527 T1 19840315; DE 3012999 A1 19811015; DE 3012999 C2 19840216; HK 30986 A 19860509; JP H0146597 B2 19891009; JP S56152989 A 19811126; US 4391679 A 19830705

DOCDB simple family (application)

**EP 81102316 A 19810327**; AT 81102316 T 19810327; DE 3012999 A 19800403; HK 30986 A 19860501; JP 4950781 A 19810403; US 25014281 A 19810402